

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2024-01-004

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2023 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、预计的经营业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：21,000万元 - 24,000万元	盈利：52,563.31万元
	比上年同期下降：54.34%-60.05%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：4,000万元 - 5,800万元	盈利：39,549.98万元
	比上年同期下降：85.34%-89.89%	
基本每股收益	盈利：0.12元/股 - 0.14元/股	盈利：0.33元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经审计机构预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩较去年同期变动的主要原因如下：

公司持续推进封装基板业务的投资扩产，并加大人才引进力度和研发投入，成本费用负担较重，对净利润造成较大拖累，其中：

1、公司控股子公司广州兴科半导体有限公司的CSP封装基板项目尚处于产能

爬坡阶段,产能利用率较低;自下半年起CSP封装基板项目产能利用率逐月回升,2023年全年亏损约0.67亿元。

2、公司控股子公司广州兴森半导体有限公司的FCBGA封装基板业务持续推进投资扩产,报告期内尚处于客户认证、打样和试产阶段,研发、测试及认证费用投入高,人工、材料、能源、折旧等费用合计投入约3.70亿元,对当期利润形成较大拖累。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步核算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司2023年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日